【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成19年7月19日(2007.7.19)

【公開番号】特開2006-38846(P2006-38846A)
【公開日】平成18年2月9日(2006.2.9)
【年通号数】公開・登録公報2006-006
【出願番号】特願2005-203323(P2005-203323)
【国際特許分類】
Ｇ０１Ｊ　1/06　(2006.01)
Ｇ０１Ｊ　1/42　(2006.01)
Ｇ０１Ｖ　8/12　(2006.01)
Ｈ０１Ｈ　35/00　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０１Ｊ　1/06　Ｚ
Ｇ０１Ｊ　1/42　Ｎ
Ｇ０１Ｖ　9/04　Ｄ
Ｈ０１Ｈ　35/00　Ｇ
Ｈ０１Ｈ　35/00　Ｖ

【手続補正書】
【提出日】平成19年5月31日(2007.5.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
送信デバイス及び受信デバイスを基板に実装するステップであって、前記基板は前記送信デバイスから放射される波を遮断する層を含んでおり、前記送信デバイス及び前記受信デバイスは前記層により画定される領域中に実装されている前記送信デバイス及び受信デバイスを基板に実装するステップと、
構造体を加工して前記送信デバイス用の第一の区画と前記受信デバイス用の第二の区画を形成するステップであって、前記区画が共通壁により分離されており、前記区画の各々が前記共通壁の少なくとも一部と連続的になっている前記形成するステップと、
前記構造体を前記基板に実装するステップとを有することを特徴とする方法。
【請求項２】
前記基板が回路基板であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記構造体が単一片の材料から作られていることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
前記共通壁が折り畳まれた二重壁であることを特徴とする請求項１から３のいずれか一つに記載の方法。
【請求項５】
前記送信デバイス及び前記受信デバイスを近接センサとして作動させるステップを更に含むことを特徴とする請求項１から４のいずれか一つに記載の方法。
【請求項６】
トランスミッタと、レシーバと、プリント回路基板（ＰＣＢ）とを具備した装置であって、

前記ＰＣＢが前記トランスミッタからの無線通信を遮断する材料の層を含み、
前記トランスミッタ及び前記レシーバが、前記ＰＣＢ上の、前記層により画定される領域上に実装されていることを特徴とする装置。
【請求項７】
前記材料の層が、１層以上の液体はんだマスク又は金属層を含むものであることを特徴とする請求項６に記載の装置。
【請求項８】
２つの区画と、
前記２つの区画を分離する共通壁であって、少なくともその一部分が前記区画の各々と連続する前記共通壁と、
前記区画の一方により画定される容積中に実質的に収容されるトランスミッタと、
前記区画の他方により画定される容積中に実質的に収容されるレシーバとを有することを特徴とする装置。
【請求項９】
前記共通壁が折り畳まれた二重壁であることを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
前記トランスミッタ、前記レシーバ及び前記区画が、プリント回路基板（ＰＣＢ）上に実装されていることを特徴とする請求項８又は９に記載の装置。